



Bruxelles, den 9. september 2025
(OR. en)

12656/25
ADD 1

ENV 815
MI 635
DELECT 125

FØLGESKRIVELSE

fra:	Martine DEPREZ, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
modtaget:	8. september 2025
til:	Thérèse BLANCHET, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union
Komm. dok. nr.:	C(2025) 5939 final - Annex
Vedr.:	BILAG to Kommissionens delegerede direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i loddemateriale med højt smeltepunkt

Hermed følger til delegationerne dokument C(2025) 5939 final - Annex.

Bilag: C(2025) 5939 final - Annex



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 8.9.2025
C(2025) 5939 final

ANNEX

BILAG

to

Kommissionens delegerede direktiv

**om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en
undtagelse for bly i loddemateriale med højt smeltepunkt**

BILAG

I bilag III til direktiv 2011/65/EU affattes punkt 7.a således:

"7.a	Bly i loddemateriale med højt smeltepunkt (dvs. blylegeringer med 85 vægtprocent bly eller mere)	Gælder for alle kategorier (bortset fra anvendelser, der er omfattet af undtagelse 24 i dette bilag) og udløber den 30. juni 2027.
7.a.I	Bly i loddemateriale med højt smeltepunkt (dvs. blylegeringer med 85 vægtprocent bly eller mere) til interne forbindelser til påsætning af chips eller andre komponenter sammen med en chip i samlingen af halvledere med stationær tilstand eller transient strøm/impulsstrøm på 0,1 A eller derover eller blokerende spænding på over 10 V eller en chip, hvis kanter er større end 0,3 mm x 0,3 mm.	Gælder for alle kategorier (bortset fra anvendelser, der er omfattet af undtagelse 24 i dette bilag) og udløber den 31. december 2027.
7.a.II	Bly i loddemateriale med højt smeltepunkt (dvs. blylegeringer med 85 vægtprocent bly eller mere) for integrerede (dvs. interne og eksterne) forbindelser til påsætning af chips i elektriske og elektroniske komponenter, hvis alle følgende betingelser er opfyldt: – varmeledningsevnen af det hærdede/sintrede materiale til påsætning af chips er $> 35\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ – den elektriske ledningsevne af det hærdede/sintrede materiale til påsætning af chips er $> 4,7 \text{ MS/m}$ — solidus er højere end 260 °C	Gælder for alle kategorier (bortset fra anvendelser, der er omfattet af undtagelse 24 i dette bilag) og udløber den 31. december 2027.
7.a.III	Bly i loddemateriale med højt smeltepunkt (dvs. blylegeringer med 85 vægtprocent bly eller mere) i loddесamlinger på første niveau (interne eller integrerede forbindelser, dvs. interne og eksterne) til fremstilling af komponenter, således at efterfølgende montering af elektroniske komponenter på underenheder (dvs. moduler, delkredsløbskort, substrater eller punkt-til-punkt-lodning) med et sekundært loddemateriale ikke blandes med materialet fra lodning på første niveau. Dette underpunkt omfatter ikke påsætning af chips og	Gælder for alle kategorier (bortset fra anvendelser, der er omfattet af undtagelse 24 i dette bilag) og udløber den 31. december 2027.

	hermetiske forseglingsmaterialer	
7.a.IV	Bly i loddemateriale med højt smeltepunkt (dvs. blylegeringer med 85 vægtprocent bly eller mere) i loddesamlinger på andet niveau til fastgørelse af komponenter på trykte kredsløbskort eller leadframes 1. i loddekugler til fastgørelse af keramiske kuglegitre (ball grid array (BGA)) 2. i plastoverstøbninger ved høj temperatur (> 220 °C)	Gælder for alle kategorier (bortset fra anvendelser, der er omfattet af undtagelse 24 i dette bilag) og udløber den 31. december 2027.
7.a.V	Bly i loddemateriale med højt smeltepunkt (dvs. blylegeringer med 85 vægtprocent bly eller mere) som hermetisk forseglingsmateriale mellem: 1. et keramisk hus eller stik og et metalhus 2. komponenttermineringer og en intern delkomponent	Gælder for alle kategorier (bortset fra anvendelser, der er omfattet af undtagelse 24 i dette bilag) og udløber den 31. december 2027.
7.a.VI	Bly i loddemateriale med højt smeltepunkt (dvs. blylegeringer med 85 vægtprocent bly eller mere) til etablering af elektriske forbindelser mellem lygtekomponenter i infrarøde lamper med indbygget reflektor, højtryksdamplamper eller ovnlamper	Gælder for alle kategorier (bortset fra anvendelser, der er omfattet af undtagelse 24 i dette bilag) og udløber den 31. december 2027.
7.a.VII	Bly i loddemateriale med højt smeltepunkt (dvs. blylegeringer med 85 vægtprocent bly eller mere) for lydtransducere, hvor den maksimale driftstemperatur overstiger 200 °C	Gælder for alle kategorier (bortset fra anvendelser, der er omfattet af undtagelse 24 i dette bilag) og udløber den 31. december 2027."